

性能特点

- 无硅体系，低挥发物
- 高导热系数，低热阻
- 耐高低温性优越，耐气候性优异
- 优异的界面润湿性
- 物理、化学性能稳定，无腐蚀性

产品描述

PAKCOOL® PC-5430 是一款高性能导热相变膏，相变温度为 45~55℃，其室温时为导热泥状，超过相变温度后变为硅脂状，具有优异的润湿性和压缩性，通过调整压力和温度，使材料的 BLT 达到最小值，为获得最佳性能，该厚度通常需小于 0.04mm。该材料必须达到相变温度，才能展现其应有的性能。该产品是一种可返工的相变材料，应用于发热面和散热面之间的缝隙填充，能有效降低界面热阻，提高散热效率，可快速有效地降低电子元件的温度，从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。

该产品除具有良好的导热性能和相变特性外，使用过程中不会有泵出、变干或渗油的问题。其在相变温度以上可与硅脂一样进行丝网印刷，也能在室温下进行点胶作业。

典型应用

- 微型处理器
- IGBT
- 集成电路
- 功率转换器
- 通讯设备
- 计算机及其附件

注意事项

- 如客户需要更详细的说明，请与我公司市场销售部联系。他们会随时为您解答和服务。
-

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。

技术参数

特性	PC-5430	测试方法
颜色	灰色	目测
导热系数(W/m·K)	≥3.0	ASTM D5470
热阻@40psi, (K·in ² /W)	≤0.02	ASTM D5470
挥发物 (% @150℃×3hrs)	≤0.3	GB 33372-2020
密度(g/cm ³)	3.0±0.1	ASTM D792
体积电阻率(Ω·cm)	≥1.0×10 ¹⁴	ASTM D257
介电强度 (KV/mm)	≥20	ASTM D149
连续使用温度(℃)	-40~150	--

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

使用方法

- 清洁涂覆件表面，将足够量的本产品通过涂抹、挤出或自动点胶填充于需冷却的电子元件与散热器/壳体等之间，使其紧密接触。每次用完应密封以备后用。如需进行丝网印刷操作，需将胶料温度全程保持在相变温度以上。

包装储运

- 本产品可提供 30mL、55mL 点胶针筒，1Kg，5Kg 和 20Kg 的塑料桶装，或根据客户要求定制包装。
- 本产品无毒、不易燃，桶装产品室温下的储存期约 12 个月，如有在储藏期间有渗油出现，应将其搅拌均匀后使用；产品需存放于原包装内，并及时盖紧盖子以防污染。请按照产品标签上标注的条件进行储存。并在标签所示有效期内使用。
- 可以作为一般液体化学品运输。